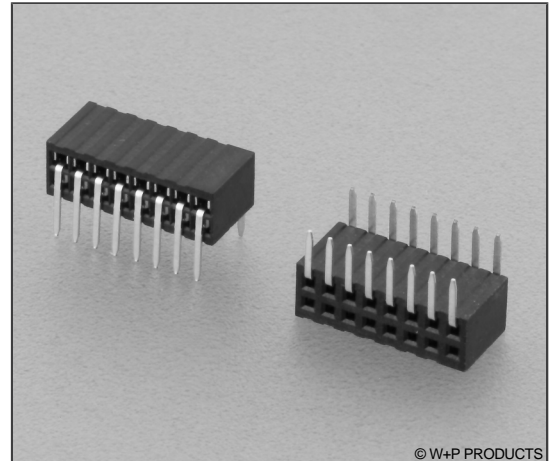


## Buchsenleisten RM 1,27mm, seitlich steckbar, 2-reihig Female Headers, 1.27mm Pitch, Side Entry, Double Row

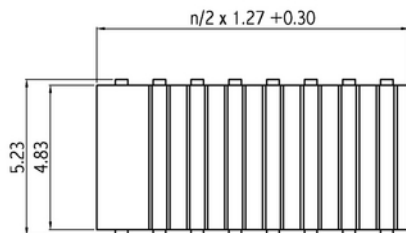
### Technische Daten / Technical Data

Isolierkörper	Thermoplastischer Kunststoff, nach UL94 V-0
<i>Insulator</i>	<i>Thermoplastic, rated UL94 V-0</i>
Kontaktmaterial	Kupferlegierung
<i>Contact Material</i>	<i>Copper alloy</i>
Kontaktoberfläche	Lt. Oberflächenoptionen, über Ni (1,3 ... 2,5µm)
<i>Contact Surface</i>	<i>Acc. to options (see below), over Ni (1.3 ... 2.5µm)</i>
Durchgangswiderstand	< 20mΩ
<i>Contact Resistance</i>	<i>&lt; 20mΩ</i>
Isolationswiderstand	> 1000MΩ
<i>Insulation Resistance</i>	<i>&gt; 1000MΩ</i>
Spannungsfestigkeit	500V <sub>AC</sub>
<i>Test Voltage</i>	<i>500V<sub>AC</sub></i>
Nennstrom	1A
<i>Current Rating</i>	<i>1A</i>
Temperaturbereich	-40°C ... +105°C
<i>Temperature Range</i>	<i>-40°C ... +105°C</i>
Verarbeitung	Wellen- oder Reflow-Lötverfahren
<i>Processing</i>	<i>Wave or reflow soldering</i>

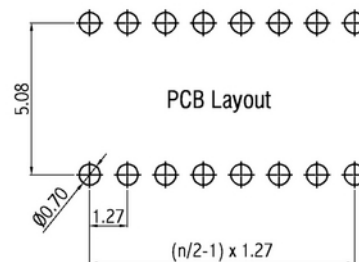
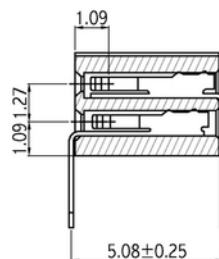
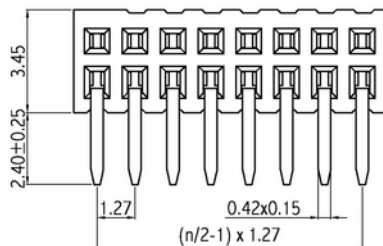
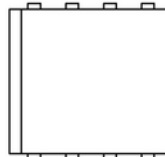


© W+P PRODUCTS

Doppelfederkontakte für Vierkantstifte 0,40mm.  
Dual beam contacts accept 0.40mm square pins.



06/08 Kontakte: Glatte Oberfläche  
06/08 Contacts: Flat Surface



Series

**713**

Contacts\*

**060**

006-080 Zweireihig  
Double row

Plating\*

**00**

00 Vergoldet  
Gold plated  
50 Verzinkt  
Tin plated  
60 Sel. Au/Sn  
Duplex plating

\* Dies ist ein **Bestellbeispiel** -  
bitte durch Ihre Spezifikationen ersetzen.  
\* This is an **order example** -  
please replace by your specifications.

### Empfehlungen für das Wellenlötverfahren

#### Recommendations for Wave Soldering

Die Bauteile sollten bei einer Lötbadtemperatur von 260°C in max. 5 Sekunden verlötet werden.  
*Items should be soldered at a solder temperature of 260°C in 5 seconds max.*

Empfohlenes Wellenlötprofil:  
*Recommended wave soldering profile:*



### Reflow-Lötempfehlung

*Reflow Soldering Recommendation*

Die Bauteile sollten gemäß folgendem Temperatur-Profil in Anlehnung an die IPC/JEDEC J-STD-020C für bleifreies Löten im Reflow-Verfahren verarbeitet werden (Maximalwerte).

Profileigenschaft	Kennwert
Temperatur Minimum $T_{Smin}$	150°C
Temperatur Maximum $T_{Smax}$	200°C
Dauer $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Temperatur Lötbereich $T_L$	217°C
Verweildauer oberhalb $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Höchsttemperatur $T_P$	260°C ±5
Dauer Höchsttemperatur	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Dauer 25°C - Höchsttemperatur $T_P$	Max. 8 min

*Items should be soldered according to IPC/JEDEC J-STD-020C temperature profile for leadfree reflow soldering (maximum values).*

Profile Feature	Key Values
Minimum Temperature $T_{Smin}$	150°C
Maximum Temperatur $T_{Smax}$	200°C
Duration $T_{Smin} - T_{Smax}$	60-180s
Soldering Range Temperature $T_L$	217°C
Duration above $T_L$	60-180s
Ramp-Up Rate $T_{Smax} - T_P$	max. 3°C / s
Peak Temperature $T_P$	260°C ±5
Duration Peak Temperature	20-40s
Ramp-Down Rate $T_{Pmax} - T_{Smin}$	6°C / s
Duration 25°C - Peak Temp. $T_P$	Max. 8min

